

계 시 판

「필리핀 경제 및 투자환경 설명회」 개최 안내

본회는 오는 4월 19일 필리핀대사관 무역투자진흥국 및 한국반도체 산업협회와 「The Right Choice : Philippiness 2001」이라는 주제로 다음과 같이 필리핀 경제 및 투자환경 설명회를 공동 개최할 예정입니다.

금번 설명회에는 필리핀 자유수출공단(PEZA) 청장 및 인사를 초빙하여 필리핀의 주요 전자산업 단지에 대한 투자환경과 더불어 필리핀의 기업환경 및 다양한 사업기회에 대한 생생하고 심도있는 정보를 제공할 예정이오니 관심있는 업체의 많은 참석 바랍니다.

— 다음 —

- 일시 : 2001. 4. 19(목) 14:00~16:00
- 장소 : Marriott호텔 미팅룸 No.2(3층)
- 연사 : H.E.Ambassador Juanito P. Jarasa(주한 필리핀 대사), Hon.Dir.Gen Lilia B. de Lima of PEZA(필리핀 자유수출공단 청장) 등
- 문의처 : 한국전자산업진흥회
국제통상팀 대리 장일주
T : 02-553-0941(교환212)
F : 02-3452-2229
E-mail : willy@mail.eiak.or.kr

한국전자산업진흥회내 기자실 (Press Room) 신설 및 이용안내

본회에서는 회원사 홍보를 위한 서비스를 적극 추진하기 위하여 기자실(Press Room)을 마련하였습니다.

회원사 대표께서는 자사의 홍보에 관련된 신제품 개발, M&A, 외자유치, 합작 등 모든 내용을

메스컴을 통하여 보도할 필요가 있을 시는 언제든지 본회 기자실(Press Room)을 이용하여 주시기 바라며, 본회에서는 출입기자단(현재 25개사 26명)을 통하여 적극 홍보해 드릴 계획이오니 많은 활용을 하여 주시면 감사하겠습니다.

문의사항은 다음을 참고하시기 바랍니다.

— 다음 —

- 기자실(Press Room) : 한국전자산업진흥회 11층
- 연락처 : 전화 (02)554-3910
팩스 (02)554-3911
- 담당자 : 전자산업연구소 이인수

2001년도 정보화촉진기금 융자사업 제2차 사업계획

1. 선도기술개발보급 지원사업

가. 지원분야

| 구 분 | 전 략 기 술 | |
|--------|------------------------------|---------------------------|
| 차세대인터넷 | • 인터넷망기술 | • 인터넷응용기술 |
| 정보보호 | • 정보보호기반기술 • 시스템/네트워크보호기술 | • 응용서비스보호기술 |
| 광통신 | • 교환기술 • 가입자망기술 | • 광전송기술 • 구내망기술 |
| 디지털방송 | • 방송망/서비스기술 • 제작/편집기술 | • 방송신호처리기술 |
| 무선통신 | • 단말기술 • 위성통신기술 | • 무선시스템기술 |
| 소프트웨어 | • 컴포넌트소프트웨어 • 디지털컨텐츠기술 | • 정보처리기술 • 게임 |
| 컴퓨터 | • 서버기술 • 시스템소프트웨어기술 | • 단말기술 |
| 정보가전 | • 홈네트워크기술 • 정보가전 소프트웨어기술 | • 홈서버 및 단말기술 |
| 핵심부품 | • 광통신기술 • 컴퓨터기술 | • 무선통신기술 • 반도체기술개발기반조성 |

계 시 판

- 정보통신부의 지원으로 수행한 출연 연구개발사업의 결과물을 기술이전을 통하거나, 자체적으로 산업적 용도로 활용하기 위한 기술개발

※ 산업적 연구 및 경쟁전단계 개발만 지원

- 국가적으로 시급히 확보되어야 하나 투자 규모가 커서 개별 기업이 감당하기 어려운 기술개발

나. 지원규모 : 1,200억원

다. 지원조건

- 융자금리 : 연 5.75%(중소기업은 연 5.25%)
- 융자기간 : 5년 이내(거치기간 2년 포함)
- 지원범위 : 소요자금의 80% 이내
- 지원한도
 - 과제당 한도 : 20억원 이내
 - 동일인 한도 : 50억원 이내

라. 중점 지원분야

- 정보통신부의 지원으로 수행한 출연 연구개발사업의 후속과제 우선지원
(예 : 선도기반 기술개발사업, 우수 신기술 지정·지원사업)
- 중소기업 우대지원
- 신규통신사업자용 장비 및 부품개발분야
- 멀티미디어, 소프트웨어 및 IP/CP산업 관련 기술개발분야

2. 멀티미디어산업 지원사업

가. 지원분야

- 멀티미디어관련 중소기업의 창업지원
 - 창업일로부터 7년 이내인 멀티미디어분야 창업 중소기업의 시설 및 운전자금 지원
- 멀티미디어관련 중소기업간 공동협력사업 지원
 - 생산시설, 연구 및 교육시설, 유통시설 등의 공동설치 및 운전자금 지원

나. 지원규모 : 60억원

다. 지원조건

- 융자금리 : 연 6.0%
- 융자기간 : 5년 이내(거치기간 2년 포함)

- 지원범위 : 소요자금의 80% 이내
- 지원한도 : 업체(사업)당 10억원 이내

라. 특기사항

- 지원대상 : 중소기업기본법에 의한 중소기업(창업지원의 경우에는 창업일로부터 7년 이내)
- 시설자금 : 시설도입 확인후 기성고 방식으로 지원
- 운전자금 : 시설자금이 지원되는 업체에 대해 1회전의 소요운전자금 지원

3. 신청서 교부 및 접수

가. 교부 및 접수기간

- 2001년 4월2일(월)~2001년 4월20일(금)

나. 전산접수 및 신청서 교부

- 정보통신연구진흥원 인터넷 홈페이지(<http://www.ita.re.kr>) “공지사항”란 참조

4. 기금 지원방법

- 본 용자사업의 정보화촉진기금지원은 지정 기금취급은행으로 부터 신용, 신용보증, 지급보증 및 담보 등의 채권보전조치를 마친 후 지원하게 됩니다.
- 기금취급은행 : 26개 금융기관(사업안내서 참조)

5. 기타

- 사업신청은 인터넷을 통한 전산접수를 꼭 하신 후 홈페이지에서 제공되는 양식에 따라 사업계획신청서(부속서류 포함)를 작성하여 접수처에 직접 접수하여 주시기 바랍니다.
- 인터넷 전산접수 및 자세한 안내는 정보통신연구진흥원 홈페이지(<http://www.ita.re.kr>)를 참고하시기 바랍니다.
- 기타 자세한 사항은 정보통신연구진흥원 산업기반사업부(전화번호:042-869-1331~4, 042-869-1311~7)로 문의하여 주시기 바랍니다.

2001년 부품·소재 기술개발 대상과제 발표

산자부, 유망 부품·소재 204개 발굴·제시

- 산업자원부는 향후 Global Sourcing 참여 잠재력이 크고, 완제품 산업의 경쟁력의 제고를 위하여 개발이 시급한 204개 핵심 부품·소재를 발굴하여 공고하였다. 이들 품목은 2000년 부품·소재 기술개발대상 중 개발필요성이 남아 있는 품목과 새로이 125개 품목이 발굴 제시된 것이다.

| | 기계류 부품 | 자동차 부품 | 전자부품 | 전기부품 | 금속소재 | 화학소재 | 섬유소재 | 계 |
|--------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|-----|
| 품목수(개) | 30 | 18 | 49 | 26 | 21 | 38 | 22 | 204 |
| 품목예 | 반도체 장비용 진공펌프용 | 고압 연료분사 장치 | 광통신 부품 온도조절 모듈 | 프라즈마 발생장치용 부품 | 전자파 차폐용 소재 | 환경 친화형 윤활 소재 | 산업용 폴리에스터 | - |

- 금번 발굴된 유망 부품·소재는 부품·소재의 수출입 실태조사, 국내의 기술수준비교, 개발 잠재력 및 시장창출효과를 종합적으로 고려하여 선정하였다. 이들 조사에는 작년 9월부터 통합연구단 소속 공동연구기관, 업종단체, 관련 기업체 전문가 등 약 400여명이 참여하였다. 또한 '부품·소재 기술개발전략 및 외국인투자유치 대토론회(3. 15(목))'에서 부품·소재통합연구단에서 국내 개발이 되어 있으나 선진국 수준으로 품질향상(Up-grade)이 필요하다고 제시한 품목 중 기술개발대상으로 적합한 품목(15개)도 포함된다.
- 이번에 발굴된 204개 대상 품목을 개발하고자 하는 기업·기관은 418(수)까지 당해 품목의 기술개발사업계획을 수립하여 한국산업기술평가원(www.itep.re.kr)에 신청하여야 한다. 접수된 개발과제에 대하여는 기술개발능력을 평가하는 기술성평가를 통과하고 투자기관들로부터 시장성을 인정받아 투자유치에 성공하는 경우 기술개발사업자로 선정하게 된다.

- 부품·소재 기술개발자금 규모 : 총 767억원 (계속과제 지원액 포함)
- ※ 기술개발 지원 과제수 : (2000) 45개 과제 → (2001) 55개 이상 목표
- 아울러 개발효과는 크지만 투자위험이 따르는 생산기업 공동 개발과제(21개)는 컨소시엄 구성을 통하여 개발위험을 분산하는 형태로 개발을 추진하게 된다.
- 특히 금년부터는 기술성평가를 강화하여 과제 선정부터 개발종료시까지 일관되게 개발사업을 평가·관리하는 기술성 평가사업단을 구성하여 과제 성공도에 따라 평가자에게 인센티브를 제공하는 등 평가책임제를 도입할 예정이다.

[첨부] 부품·소재 기술개발대상 과제 목록

- 전기·전자 분야 (72개)
 - 반도체 소자용 에피웨이퍼
 - 초소형/고용량 적층 칩세라믹 콘덴서
 - 인터넷 자동 접속 모듈
 - Network Module용 Magnetic Module
 - COFDM 송신모듈
 - 인터넷 방송용 무선 오디오 부품
 - 무선모뎀용 IC 및 칩셋
 - 소출력 무선 네트워크 부품
 - 멀티미디어 브리지 칩셋
 - 디지털 지상파/케이블 방송용 VSB/QAM 공용 Decoder Chip
 - 정보가전 칩셋
 - 다층 PCB 및 제조 장비 핵심부품
 - 반도체 공정장비용 핵심부품
 - 평판 디스플레이용 부품 및 소재
 - 2차전지
 - 전자부품용 소재(압전, 유전, 자성, 금속, 절연)

계 시 판

- PCS/셀룰러용 부품 및 소재
 - IMT-2000용 모듈
 - 매키니즘 모듈
 - 전기/전자 기기용 센서 및 소재
 - 2.5Gbps 광통신 저가격 아날로그 IC
 - 200W 급 센서리스형 SR
(Switched Reluctance Motor)
 - 광통신용 광커플러
 - 고집적 VFD(형광표시판) 구동 IC
 - 고품위 전광판 소자
 - 광통신용 모듈
 - 광통신 부품용 온도조절 모듈
 - 네트워크 접속용 영상제어 IC
 - 디지털 방송용 칩
 - IMT-2000용 부품 및 소재
 - 자동차용 POWER IC
 - Bluetooth용 부품 및 소재
 - Bluetooth용 모듈
 - 연속 음성 인식 칩
 - 초소형 마이크로폰
 - 충돌방지용 77GHz 트랜스터 및 리시버
 - 광통신용 광증폭기
 - BGA PKG 소재
 - PWM 방식의 2상 Stepping Motor Drive IC
 - RF MMIC Switch
 - 고주파용 칩 저항기
 - Universal Serial Bus 2.0 칩
 - VODSL(Voice Over Digital Subscriber Line)
핵심 칩셋
 - VoIP Processor
 - 연료전지용 부품 및 소재
 - 전력용 초고속 다이오드
 - 고집적 초소형 전압제어발전기
 - 증기발생기 전열관 누설감시용 측정장치
핵심부품
 - 열차정지장치용 지상자용 검측장치(ATS)
핵심부품
 - 전기제어 감시장비 부품
 - 12GHz 이상의 스펙트럼 분석기 핵심부품
 - 고전압기기용 폴리머 부품 및 소재
 - 소형정밀모터
 - 초고속 정밀 모터
 - 광통신용 광커넥터
 - ZnO 바리스터
 - 고전압용 절연 부품
 - 초고압용 붓싱
 - 아크 용접기용 핵심부품
 - 변전 및 배전급 차단기용 핵심부품
 - 소형 무접점 릴레이
 - 지능형 로봇용 서보전 제어 부품
 - Simulator용 선형 전동기
 - 전선용 내열 절연피복재
 - 전기절연용 컴파운드
 - 전략반도체 보호용 퓨즈
 - Hi-Fi 1-chip Digital Audio Amplifier
 - 수차제어용(NCS) 모듈
 - 플라즈마 발생장치용 부품
 - 반도체 제조설비 Stocker용 전원공급기기용부품
 - 전기자동차용 영구자석 전동기
- 생산기업공동개발사업(21개)
- IMT-2000용 마이크로디스플레이 모듈
 - 저장장치 및 대내망 접속 모듈
 - 세척기용 초음파 발생장치
 - 전력용스위칭 시스템 구성부품
 - 핵심엔지니어링 불소수지 개발
 - 실리콘 모노머 및 폴리머 개발
 - Cellulose계 재생 섬유·가공소재
 - 극선명초미세 고부가가치날염직물
 - 고온(500°C) 보일러용Cr-Mo 합금강관
 - 반도체 리드프레임 동합금 재료
 - 반도체용 정밀강관(EP grade)
 - 자동차 엔진밸브용 내열강봉
 - 자동차 외관재용 용융 아연도금(Galvanneal) 강판
 - 자동차용 Hydroforming 강관
 - Steering Rack & Pinion 용 Steel Bar 소재
 - LLDPE 응용 화학소재 개발
 - 고강도 PVA 섬유소재
 - 고성능 타이어코드 섬유소재
 - 폴리에스터 심색 섬유소재
 - PTT 단섬유 소재
 - HOMO PAN 섬유소재